PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-268327

(43) Date of publication of application: 09.10.1998

(51)Int.CI.

G02F 1/1339 G02F 1/1339

(21)Application number: **09-075349**

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22) Date of filing:

27.03.1997 (72)Invento

(72)Inventor: NARUOKA SATORU

MORIMOTO HIROKAZU

NISHINO TETSUYA MUROUCHI KATSUNORI

HONDA TADASHI TANAKA TAKAOMI

KURAUCHI SHOICHI

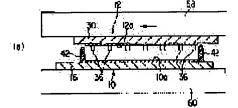
(54) METHOD FOR ASSEMBLING LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

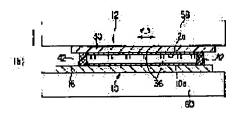
(57) Abstract:

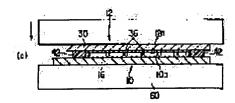
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide the assembling method for a liquid crystal display device which can assemble a liquid crystal display device with improved picture quality at

high yield.

SOLUTION: On the top surface of an array substrate 10, a sealing material 42 is provided surrounding a display area 10a and formed exceeding the height of spacers 36 provided on the side of a counter substrate 12. While the array substrate 10 and counter substrate 12 are arranged opposite each other, the counter substrate 12 is moved toward the array substrate 10 and those substrates are temporarily sealed with the sealing material 42. At this time, the substrates are temporarily sealed while the tips of the spacers 36 are separated from the display area of the array substrate 10. In this state, the array substrate 10 and counter substrate 12 are moved relatively and positioned. After they are positioned, the counter substrate 12 is pressed against the array substrate 10 until the tips of the spacers 36 come into contact with the display area of the array substrate 10, and both the substrates are actually sealed with the sealing material 42.







LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the

examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

POWERED BY Dialog

Basic Patent (Number, Kind, Date): JP 10268327 A2 981009

PATENT FAMILY:

Japan (JP)

Patent (Number, Kind, Date): JP 10268327 A2 981009

METHOD FOR ASSEMBLING LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE (English)

Patent Assignee: TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO

Author (Inventor): NARUOKA SATORU; MORIMOTO HIROKAZU; NISHINO TETSUYA; MUROUCHI KATSUNORI; HONDA TADASHI; TANAKA TAKAOMI; KURAUCHI SHOICHI

Priority (Number, Kind, Date): JP 9775349 A 970327 Applic (Number, Kind, Date): JP 9775349 A 970327

IPC: * G02F-001/1339

Derwent WPI Acc No: * G 98-598738; G 98-598738

Language of Document: Japanese

INPADOC/Family and Legal Status
© 2001 European Patent Office. All rights reserved.
Dialog® File Number 345 Accession Number 14766630

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-268327

(43)公開日 平成10年(1998)10月9日

(51) Int.Cl.8

識別記号

G 0 2 F 1/1339

505

500

FΙ

G 0 2 F 1/1339

505

500

審査請求 未請求 請求項の数6 〇L (全 10 頁)

(21)出願番号

特願平9-75349

(22)出願日

平成9年(1997) 3月27日

(71)出願人 000003078

株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

(72)発明者 成岡 覚

兵庫県姫路市余部区上余部50番地 株式会

社東芝姫路工場内

(72)発明者 森本 浩和

兵庫県姫路市余部区上余部50番地 株式会

社東芝姫路工場内

(72)発明者 西野 哲哉

兵庫県姫路市余部区上余部50番地 株式会

社東芝姫路工場内

(74)代理人 弁理士 鈴江 武彦 (外6名)

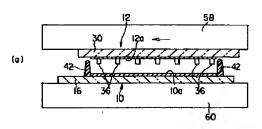
最終頁に続く

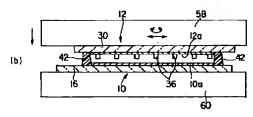
(54) 【発明の名称】 液晶表示装置の組立方法

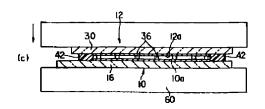
(57)【要約】

【課題】画質の向上した液晶表示装置を高い歩留まりに て組立可能な液晶表示装置の組立方法を提供することに ある。

【解決手段】アレイ基板10の表面上には、表示領域10aを囲むようにシール材42が設けられ、このシール材は、対向基板12側に設けられたスペーサ36の高さよりも高く形成されている。アレイ基板と対向基板とを対向配置した状態で、対向基板をアレイ基板側へ移動させ、シール材によってこれらの基板同志を仮封着する。その際、スペーサの先端がアレイ基板の表示領域から離間した状態で、基板同志を仮封着する。そして、この状態でアレイ基板および対向基板を相対的に移動して相互間の位置合わせを行う。位置合わせ後、スペーサの先端がアレイ基板の表示領域に接触するまで、対向基板をアレイ基板側へ押圧し、シール材によって両基板同志を本封着する。







【特許請求の範囲】

s

【請求項1】電極が設けられた第1の基板と、スペーサおよび電極が設けられた第2の基板と、を用意し、

上記第1 および第2 の基板の内、一方の基板上に、表示 領域を囲むようにシール材を設け、

上記第1の基板の表示領域が上記スペーサに接触しない 状態で上記第1および第2の基板が対向するように、上 記シール材を介して上記第1および第2の基板を貼り合 わせて仮封着し、

上記仮封着された第1および第2の基板の少なくとも一方を移動して基板同士の位置合わせを行い、

上記位置合わせが終了した後、上記スペーサを介して上記第1および第2の基板同士が接触するように少なくとも一方の基板を加圧するとともに、上記シール材を硬化させて本封着することを特徴としている。

【請求項2】上記仮封着時、上記スペーサが上記第1の基板の表示領域に接触しないように、上記シール材の高さ、幅、粘度、および上記第1、第2の基板に印加する圧力の少なくとも1つを調整することを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置の組立方法。

【請求項3】電極が設けられた第1の基板と、電極および所定高さのスペーサが設けられた第2の基板と、を用意し、

上記第1および第2の基板の内、一方の基板上に、表示 領域を囲むように、上記スペーサよりも高さの高いシー ル材を設け、

上記第1および第2の基板を上記シール材を介して貼り合わせ、上記第1および第2の基板の表示領域が上記スペーサの高さよりも広い間隔を置いて対向するように、上記第1および第2の基板を対向配置し、

上記貼り合わされた第1および第2の基板の少なくとも 一方を移動して基板同士の位置合わせを行い、

上記位置合わせが終了した後、上記スペーサを介して上記第1および第2の基板同士が接触するように少なくとも一方の基板を加圧するとともに、上記シール材を硬化させることを特徴とする液晶表示装置の組立方法。

【請求項4】電極が設けられた第1の基板と、電極および所定高さのスペーサが設けられた第2の基板と、を用意し、

上記第1および第2の基板の内、一方の基板上に、表示 40 領域を囲むように第1のシール材を設けるとともに、上 記第1のシール材の外側に、上記スペーサよりも高さの 高い第2のシール材を設け、

上記第1および第2の基板の表示領域が上記スペーサの 高さよりも広い間隔を置いて対向するように、上記第1 および第2の基板を上記第2のシール材により貼り合わ せて仮封着し、

上記仮封着された第1および第2の基板の少なくとも一方を移動して基板同士の位置合わせを行い、

上記位置合わせが終了した後、上記スペーサを介して上 50 ージをX、Y、 θ 方向に移動して位置合わせを行う。位

記第1および第2の基板同士が接触するように少なくとも一方の基板を加圧し、上記第1のシール材を介して第1および第2の基板同士を貼り合わせて本封着することを特徴とする液晶表示装置の組立方法。

【請求項5】上記第2のシール材は、上記スペーサの高さよりも大きな径を有する粒子を含んでいることを特徴とする請求項4に記載の液晶表示装置の組立方法。

【請求項6】上記本封着の後、上記第2のシール材で貼り合わされた部分を切除することを特徴とする請求項4 10 又は5に記載の液晶表示装置の組立方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は液晶表示装置の組立方法、特に、スペーサを挟んで互いに対向した2枚の基板を有する液晶表示装置の組立方法に関する。

[0002]

【従来の技術】一般に、液晶表示装置は、電極を有する2枚のガラス基板の周縁部同士をシール材を介して貼り合わせ、これらのガラス基板間に液晶を封入して構成されている。2枚のガラス基板間のギャップを一定に保つため、スペーサとして粒径の均一なプラスティックビーズ等をガラス基板間に散在させている。

【0003】また、粒子からなるスペーサに代えて、フォトレジスト等によって一方の基板上に突起状のスペーサを形成した液晶表示装置も提案されている。上記のように構成された液晶表示装置は、通常、以下の工程によって組立られる。

【0004】すなわち、まず、互いに対向した上下一対のステージにガラス基板をそれぞれ吸着保持する。この30場合、下ステージ上に保持されたガラス基板の表面上には、多数の電極が形成されているとともに、表示領域を規定する矩形枠状のシール材と、2枚のガラス基板間のギャップを保持するためのスペーサとが配置されている。また、上ステージに保持されたガラス基板には、対向電極、カラーフィルタ等が設けられている。

【0005】この状態で、2枚のガラス基板が所定の隙間をおいて対向するように上ステージを下降させた後、上ステージをX、Y方向に移動、および2軸回りで回動することにより、2枚のガラス基板同志を、所定の位置合わせマーク等を基準として位置合わせする。

【0006】続いて、上側のガラス基板が下側のガラス基板上のシール材およびスペーサに接触する位置まで上ステージを下降させる。この場合、2枚のガラス基板がスペーサやシール材を介して接触する際の抵抗や、上下ステージの上下駆動の剛性、平行度、さらには、X、Y、 θ 駆動機構におけるバックラッシュ等に起因して、両ガラス基板間に微妙な位置ずれが生じる。

【0007】そこで、2枚のガラス基板がシール材およびスペーサを介して互いに接触した状態で、再度上ステージをX、Y、6方向に移動して位置合わせを行う。位

置合わせ終了後、2枚のガラス基板間のギャップが所定 の値となるように加圧するとともにシール材を硬化させ る。その後、これらのガラス基板間に液晶分子を封入す る。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記のように2枚のガラス基板がスペーサを介して互いに接触した状態で一方のガラス基板を移動させて位置合わせを行う場合、一方のガラス基板上に固定的に形成された柱状のスペーサが他方のガラス基板上に形成された配向膜等の表面を強く擦って傷を付けてしまうとともに、ガラス基板表面のカラーフィルタ層等にめり込んでしまう虞むある。

【0009】そして、近年の液晶表示装置においては画質の向上が強く要望されていることから、製造工程中に生じた僅かな傷についても画質不良として上げられ、製造歩留りを低下させる要因となる。

【0010】この発明は以上の点に鑑みなされたもので、その目的は、画質の向上した液晶表示装置を高い歩留まりにて組立可能な液晶表示装置の組立方法を提供することにある。

[0011]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、この発明の請求項1に係る液晶表示装置の組立方法は、電極が設けられた第1の基板と、スペーサおよび電極が設けられた第2の基板と、を用意し、上記第1および第2の基板の内、一方の基板上に、表示領域を囲記ようにシール材を設け、上記第1基板の表示領域が上記れて、一サに接触しない状態で上記第1および第2の基板が対向するように、上記シール材を介して上記第1および第2の基板の少なくとも一方を移動してと第1および第2の基板の少なくとも一方を移動してと集1および第2の基板の少なくとも一方を移動してと表している。ともに、上記シール材を硬化させて本封着することを特徴としている。

【0012】請求項3に係るこの発明の組立方法は、電極が設けられた第1の基板と、電極および所定高さのスペーサが設けられた第2の基板と、を用意し、上記第1および第2の基板の内、一方の基板上に、表示領域を囲むように、上記スペーサよりも高さの高いシール材を設け、上記第1および第2の基板を上記シール材を介して貼り合わせ、上記第1および第2の基板を対向配置し、上記第1および第2の基板を対向配置し、上記第1および第2の基板の少なくとも一方を移動して基板同士の位置合わせを行い、上記位置合わせが終了した後、上記スペーサを介して上記第1および第2の基板同士が接触するように少なくとも一方の基板を加

圧するとともに、上記シール材を硬化させることを特徴 としている。

【0013】また、請求項4に係るこの発明の組立方法 は、電極が設けられた第1の基板と、電極および所定高 さのスペーサが設けられた第2の基板と、を用意し、上 記第1および第2の基板の内、一方の基板上に、表示領 域を囲むように第1のシール材を設けるとともに、上記 第1のシール材の外側に、上記スペーサよりも高さの高 い第2のシール材を設け、上記第1および第2の基板の 表示領域が上記スペーサの高さよりも広い間隔を置いて 対向するように、上記第1および第2の基板を上記第2 のシール材を介して貼り合わせ仮封着し、上記仮封着さ れた第1および第2の基板の少なくとも一方を移動して 基板同士の位置合わせを行い、上記位置合わせが終了し た後、上記スペーサを介して上記第1および第2の基板 同士が接触するように少なくとも一方の基板を加圧し、 上記第1のシール材を介して第1および第2の基板同士 を貼り合わせて本封着し、上記本封着の後、上記第2の シール材で貼り合わされた部分を切除することを特徴と 20 している。

【0014】上記構成の組立方法によれば、第1および第2の基板を、一方の基板の表示領域がスペーサに非接触な状態となるようにシール材で仮封着し、この状態で、2枚の基板同士の位置合わせを行っている。そのため、位置合わせ時に2枚の基板を相対的に移動させた場合でも、スペーサによって表示領域が擦られ傷が付くことを防止できる。そして、位置合わせ終了後、第1および第2の基板の少なくとも一方を加圧してスペーサを両基板の表示領域に接触させることにより、両基板間の間30 隔をスペーサの高さと同一の所定の値に設定する。

[0015]

【発明の実施の形態】以下図面を参照しながら、この発明の実施の形態について詳細に説明する。まず、この発明の組立方法によって組立られる液晶表示装置の構成につて説明する。図1に示すように、液晶表示装置はアクティブマトリックス型の液晶表示装置であり、互いに対向して配設された矩形状のアレイ基板10および対向基板12を備え、これらの基板間に液晶組成物14が封入されている。

【0016】アレイ基板10は矩形状のガラス基板16を備え、このガラス基板の表面上には矩形状の表示領域10aには、多数の走査線18および図示しない信号線がマトリックス状に形成されているとともに、各走査線と信号線との交差部近傍にはITOからなる画素電極20が形成されている。各画素電極20は、アモルファスシリコンを有する薄膜トランジスタ(以下TFTと称する)22を介して走査線および信号線に接続されている。画素電極20の数、つまり、液晶表示装置の画素数は、縦横100つつ、合計10000個設けられている。

4

【0017】また、画素電極20の下方には、図示しないゲート絶縁膜を介して補助容量線24が形成されている。そして、走査線18、信号線、画素電極20、TFT22を覆うように配向膜26が形成されている。この配向膜26は、配向膜材料として例えば、AL-1051(日本合成ゴム(株)製)をアレイ基板10全面に500オングストローム厚に塗布した後、ラビング処理を施すことによって形成されている。

【0018】一方、対向基板12は矩形状のガラス基板30を備え、このガラス基板の表面上には矩形状の表示領域12aが設けられている。表示領域12aには、カラーフィルタとして機能する多数の着色層34R、34G、34B、対向電極38、スペーサ36、配向膜40等が形成されている。

【0019】詳細に述べると、対向基板12の表示領域上には、マトリックス状の遮光層32が形成され、アレイ基板10側の走査線18および信号線と対向配置されている。遮光層32は、ガラス基板30表面に感光性の黒色樹脂を塗布し、乾燥後、所定パターンのフォトマスクを用いて露光し、更に、アルカリ水溶液にて現像した後、200 $\mathbb C$ 、60分の焼成にて膜厚2.0 μ mに形成されている。

【0020】また、対向基板12の表示領域12a上には、赤の着色層34R、緑の着色層34G、青の着色層34Bが形成され、それぞれ所定の配列で遮光層32間に形成されている。

【0021】赤の着色層34Rは、赤色の顔料を分散させた紫外線硬化型アクリル樹脂レジストCR-2000(富士ハントテクノロジー(株)製)を表示領域12a全面に塗布し、後述するスペーサの形成を所望する場所を含め、赤を着色したい部分のみに光が照射されるフォトマスクを介してレジストを露光し、更に、KOHの1%水溶液で現像することにより形成されている。

【0022】同様に、縁、青の着色層34G,34Bを、スペーサの形成領域を含んで繰り返し形成した後、230℃で1時間焼成する。ここでは緑の着色材料として、CG-2000(富士ハントテクノロジー(株)製)、青の着色材料としてCB-2000(富士ハントテクノロジ(株)製)を用いた。

【0023】一方、上記のような着色層34R、34 G、34Bを重ねることにより、対向基板12側からほぼ垂直に突出した棒状のスペーサ36が多数形成されている。これらのスペーサ36は遮蔽層32上に形成されているとともに、アレイ基板10側の非画素部の内、走査線18と対向する位置に形成されている。スペーサ36の高さは、 5μ m程度に設定されている。

【0024】遮光層32、着色層34R、34G、34 B上には、ITOからなる対向電極38が形成され、更 に、対向電極上に配向膜40が形成されている。配向膜 40のラビング方向は、135度に設定されている。 【0025】上記のように構成されたアレイ基板10および対向基板12は、シール材42を介して互いに貼り合わされている。シール材42は、例えば、アレイ基板10および対向基板12の表示領域10a、12aを囲むように矩形枠状に形成されている。そして、各スペーサ36の延出端はアレイ基板10側の表示領域10aの内、走査線18上の部分に接触している。それにより、アレイ基板10および対向基板12は5μmのギャップを置いて対向している。

【0026】また、配向膜26、40は、ラビング方向が90度ずれるように対向している。そして、アレイ基板10および対向基板12間に液晶組成物14が封入されている。液晶組成物14としては、ZLI-1565(E.メルク社製)にS811を0. Iwt%添加したものが用いられている。なお、シール材42の外側には、アレイ基板10から対向電極12へ電圧を印加するための図示しない電極転移材が設けられている。

【0027】次に、上記構成の液晶表示装置の組立に用いる組立装置について説明する。図2に示すように、組立装置50は、液晶表示装置の2枚の基板を貼り合わせる貼り合わ機構部52と、貼り合わ機構部52へ基板を供給する供給機構部54と、を備え、これらの貼り合わ機構部および供給機構部は本体フレーム56上に設置されている。

【0028】貼り合わ機構部52は、互いに対向配置された上ステージ58および下ステージ60を有している。これらのステージ58、60は矩形板状に形成されほぼ水平に配置されている。下ステージ60は本体フレーム56上に固定的に配設されている。

30 【0029】上ステージ58は、位置調整機構として機能する $X-Y-\theta$ ステージ62に取り付けられている。 $X-Y-\theta$ ステージ62は、水平面内において、X方向、Y方向に移動自在であるとともに、垂直軸の回りで回動可能となっている。また、 $X-Y-\theta$ ステージ62は、本体フレーム56に設けられたガイド65により、垂直方向に沿って昇降自在に支持およびガイドされ、本体フレーム56の上部に設けられた駆動機構64によって昇降駆動される。

【0030】そして、上ステージ58は、 $X-Y-\theta$ ス40 テージ62を作動させることにより、下ステージ20に対して位置調整可能であるとともに、駆動機構24によって $X-Y-\theta$ ステージ62を昇降駆動することにより、下ステージ60に対して接離する方向に移動され

【0031】上ステージ58の下面は基板保持面58a を構成し、この基板保持面には図示しない多数の吸着孔 が形成されている。これらの吸着孔は吸引チューブを介 して真空ポンプ66に接続されている。また、下ステー ジ60の上面は基板保持面60aを構成し、この基板保 50 持面には図示しない多数の吸着孔が形成されている。こ

れらの吸着孔は吸引チューブを介して真空ポンプ 6 8 に接続されている。

【0032】貼り合わ機構部52の上ステージ58および下ステージ60に基板を供給する供給機構部54は、本体フレーム56上にほぼ水平に設けられたX-Yテーブル70と、X-Yテーブル上に垂直に立設された支持ポスト72と、を備え、支持ポストには垂直方向に沿って昇降可能な移動台74が取付けられている。また、移動台74には、水平方向に延びる伸縮自在かつ回動自在な支持アーム76が取り付けられ、支持アームの延出端には、基板を吸着保持する保持部78が設けられている。

【0033】そして、供給機構部54は、保持部78により基板を吸着保持した状態で、移動台74を昇降および支持アーム76を伸縮、回動させることにより、基板を上ステージ58、および下ステージ60にそれぞれ供給する。

【0034】次に、以上のように構成された組立装置を用いて液晶表示装置を組み立てる方法について説明する。まず、図3に示すように、上述した構成を有するアレイ基板10および対向基板12をそれぞれ用意する。本実施の形態においては、例えば、300mm×400mmの大判のガラス基板16上に、10インチサイズの液晶表示装置を製造するためのアレイ基板2面分の表示領域10aを形成し、各表示領域10aを囲むようにシール材42をスクリーン印刷する。

【0035】シール材42としては、熱硬化型エポキシ 樹脂を用いている。シール材42の長さは、アレイ基板 1 面当たり約800 mm、ガラス基板 16、1 枚当たりでは約1600 mmに形成されている。また、シール材 42 の幅は約200 μ m、高さは25 μ mに印刷されている。なお、シール材 42 の一部には、液晶注入口 43 が設けられている。

【0036】対向基板12についても同様に、大判のガラス基板30上に、対向基板2面分の表示領域12aを形成したものを用いる。続いて、図4(a)に示すように、アレイ基板2面分のガラス基板16を供給機構14によって貼り合わ機構部12の下ステージ60まで供給し、表示領域10aを上にして下ステージの基板保持面60a上に載置する。この状態で、真空ポンプ68を作動させ、吸着孔によってガラス基板16を下ステージ60の基板保持面60a上に吸着保持する。

【0037】また、上記と同様の工程によって対向基板 12を構成するガラス基板 30を上ステージ 58に供給 し、真空ポンプ 66 を作動させることにより、表示領域 12 aを下に向けて上ステージの基板保持面 58 a 上に吸着保持する。この状態で、 $X-Y-\theta$ ステージ 62 よって上ステージ 88 および対向基板 12 をアレイ基板 10 に対して相対移動し、アレイ基板および対向基板を互いに位置合わせする。これにより、アレイ基板 10 およ

8 び対向基板12は、表示領域10a、12aが互いに対向した状態に配置される。

【0038】続いて、図4(b)に示すように、駆動機構64によって $X-Y-\theta$ ステージ62とともに上ステージ58を下降させ、対向基板12をアレイ基板10に接近する方向へ移動させる。そして、対向基板12側のガラス基板30をアレイ基板10側のシール材42に接触させることによりガラス基板16および30を貼り合わせ、仮封着する。

【0039】この際、シール材42の高さが、つまり、アレイ基板10と対向基板12との間隔が、各スペーサ36の高さ(5μm)よりも大きい20μm程度となるように、シール材の粘度も考慮した上、アレイ基板10に対する対向基板12の押圧力を10Kgf程度に設定して仮封着を行う。これにより、対向基板12およびアレイ基板10は、各スペーサ36の延出端がアレイ基板10の表示領域10aから離間した状態で仮封着される。

【0041】位置合わせ終了後、図4 (c) に示すように、駆動機構 64によって $X-Y-\theta$ ステージ 62とともに上ステージ 58を更に下降させ、対向基板 12をアレイ基板 10側へ移動させる。そして、対向基板 12側のガラス基板 30によってシール材 42を押し潰しながら、スペーサ 36の先端がアレイ基板 10の表示領域 100 aに接触するまで対向基板 12を下降させる。その後、シール材 42を加熱して硬化させることにより、アレイ基板 10と対向基板 12とを本封着する。その結果、アレイ基板 10 および対向基板 12は、スペーサ 36の高さに一致した所定の間隔、つまり、 5μ mの間隔を置いて貼り合わされる。

【0042】貼り合わ終了後、真空ポンプ66、68を停止してアレイ基板10および対向基板12の吸着を解除し、更に、上ステージ58をX-Y- θ ステージ62とともに上昇させる。続いて、貼り合わされたアレイ基が板10および対向基板12を、図示しない搬送機構によって下ステージ上から取り出し、次にの液晶充填部に搬送する。

【0043】液晶充填部においては、シール材42の液晶注入口43から両基板間のギャップに液晶組成物を注入した後、この液晶注入口を紫外線硬化樹脂等で封止する。以上のように構成された液晶表示装置の組立方法によれば、スペーサ36の延出端がアレイ基板の表示領域から離間した状態にアレイ基板および対向基板を仮封着し、この状態で、両基板の位置合わせを行っている。そ50のため、位置合わせ時に2枚の基板を相対的に移動させ

た場合でも、スペーサによって表示領域が擦られ傷が付くことを防止できる。その結果、傷に起因する配向不良、画像不良の発生を防止し、画質の向上した液晶表示装置を高い歩留まりにて提供することができる。更に、アレイ基板と対向基板とがスペーサを介して接触していない状態で位置合わせを行うことにより、高精度な位置合わせが可能となり、一層画質の向上を図ることができる。

【0044】なお、仮封着時における2枚の基板間の間隔は、シール材の粘度、高さ、幅、2枚の基板に作用する圧力等を制御することにより調整することができる。例えば、仮封着時、2枚の基板は、基板の周縁部に配置されたシール材のみによって支持されているため、上側の基板中央部が下側の基板側へ撓んだ状態となる場合があり、特に、基板サイズが大きくなるとこの傾向が顕著となる。そのため、基板サイズの増加に伴って仮封着時の圧力を弱く調整したり、あるいは、シール材の粘度、塗布量を調整したり、更に、その両方を行うことにより、仮封着時の基板間の間隔をスペーサに接触しない大きさに設定することができる。また、基板サイズが同で、シール材の材質や塗布量が異なる場合には、仮封着時の圧力を調整することも可能である。

【0045】図5 および図6 は、この発明の第2 の実施の形態に係る液晶表示装置の組立方法を示している。第2 の実施の形態によれば、図5 および図6 (a) に示すように、アレイ基板10 側のガラス基板16 に、各表示領域10 aを囲むようにシール材42 をスクリーン印刷するとともに、このシール材の外側に仮止め用の第2 のシール材80 を塗布する。第2 のシール材80 は、対向基板12 側に設けられたスペーサ36 の高さよりも大きな粒径を有する粒子、例えば、直径約30 μ mのセラミック球82 が混入されている。

【0046】また、第2のシール材80は、アレイ基板10の表示領域10aと対向基板12の表示領域12aとの間のセルギャップに影響を及ぼさないように、シール材42から10mm以上離間し、かつ、ガラス基板16の周縁から10mm程度離間した位置に塗布されている。更に、第2のシール材80は、最小の塗布数で十分な効果を得るために、ガラス基板16の4角に塗布されている。

【0047】なお、第2の実施の形態で使用する組立装置においては、上ステージ58の基板保持面58aおよび下ステージ60の基板保持面60aには、約0.5mm厚の弾性シート84が貼り付けられている。

【0048】アレイ基板10と対向基板12とを封着する場合、まず、図6(a)に示すように、アレイ基板2面分のガラス基板16を供給機構14によって貼り合わ機構部12の下ステージ60まで供給し、表示領域10aを上にして下ステージの基板保持面60a上に載置する。この状態で、真空ポンプ68を作動させ、吸着孔に

よってガラス基板16を下ステージ60の弾性シート84上に吸着保持する。

【0049】また、上記と同様の工程によって対向基板 12を構成するガラス基板 30を上ステージ 58に供給 し、真空ポンプ 66 を作動させることにより、表示領域 12 aを下に向けて上ステージの弾性シート 84 上に吸 着保持する。この状態で、 $X-Y-\theta$ ステージ 62 よって上ステージ 58 および対向基板 12 をアレイ基板 10 に対して相対移動し、アレイ基板 10 および 対向基板 12 は、表示領域 10 a、12 a が互いに対向 した状態に配置される。

【0050】続いて、図6(b)に示すように、駆動機構64によって $X-Y-\theta$ ステージ62とともに上ステージ58を下降させ、対向基板12をアレイ基板10に接近する方向へ移動させる。そして、対向基板12側のガラス基板30をアレイ基板10側の第2のシール材80 および第2のシール材に混入されたセラミック球82に接触させることによりガラス基板16および30を貼 り合わせ、仮封着する。

【0051】この際、セラミック球84の直径は各スペーサ36の高さ(5μ m)よりも大きい 30μ m程度に形成されているため、対向基板12およびアレイ基板10は、各スペーサ36の延出端がアレイ基板10の表示領域10aから離間した状態で仮封着される。同時に、シール材42も対向基板12から離間した状態となっている。

【0052】この状態で、 $X-Y-\theta$ ステージ62を作動させて上テーブル58および対向基板12をX、Y、 θ 方向に移動させ、対向基板の各表示領域12aををアレイ基板10の表示領域10aに対して所定位置に正確に位置合わせする。

【0053】位置合わせ終了後、図6 (c) に示すように、駆動機構64によって $X-Y-\theta$ ステージ62とともに上ステージ58を更に下降させ、対向基板12をアレイ基板10側へ移動させる。そして、対向基板12側のガラス基板30によってシール材42を押し潰しながら、スペーサ36の先端がアレイ基板10の表示領域10aに接触するまで対向基板12を下降させる。

0 【0054】この際、アレイ基板10側のガラス基板16および対向基板12側のガラス基板30の内、セラミック球82に接触している部分、つまり、仮封着された部分は、基板間の間隔が縮まることなくセラミック球82の直径と同一の間隔に維持される。そのため、ガラス基板16および30の周縁部は、中央部に対して外側に湾曲した状態に変形し、その際、この変形は、上ステージ58および下ステージ60の弾性シート84の弾性変形によって吸収される。

【0055】その後、シール材42を加熱して硬化させ 50 ることにより、アレイ基板10と対向基板12とを本封

11

着する。その結果、アレイ基板 10の表示領域 10 a および対向基板 12 の表示領域 12 a は、スペーサ 36 の高さに一致した所定の間隔、つまり、 5μ mの間隔を置いて貼り合わされる。

【0056】貼り合わ終了後、真空ポンプ66、68を停止してアレイ基板10および対向基板12の吸着を解除し、更に、上ステージ58を $X-Y-\theta$ ステージ62とともに上昇させる。続いて、貼り合わされたアレイ基板10および対向基板12を、図示しない搬送機構によって下ステージ上から取り出し、次にの液晶充填部に搬 10送する。また、アレイ基板10および対向基板12の仮封着部分は、図6(c)に示す破線Aに沿って切除される。

【0057】液晶充填部においては、シール材42の液 晶注入口43から両基板間のギャップに液晶組成物を注 入した後、この液晶注入口を紫外線硬化樹脂等で封止す る。以上のように構成された第2の実施の形態に係る液 晶表示装置の組立方法によれば、スペーサ36の高さよ りも大きな直径を持った粒子が混入された第2のシール 材80を用いてアレイ基板および対向基板を仮封着する ことにより、スペーサ36の延出端がアレイ基板の表示 領域から離間した状態にアレイ基板および対向基板を仮 封着し、この状態で、両基板の位置合わせを行ってい る。そのため、位置合わせ時に2枚の基板を相対的に移 動させた場合でも、スペーサによって表示領域が擦られ 傷が付くことを防止できる。その結果、傷に起因する配 向不良、画像不良の発生を防止し、画質の向上した液晶 表示装置を高い歩留まりにて組み立てることができる。 更に、アレイ基板と対向基板とがスペーサを介して接触 していない状態で位置合わせを行うことにより、高精度 な位置合わせが可能となり、一層画質の向上を図ること ができる。

【0058】なお、第2のシール材80に混入する粒子は、セラミック球に限らず、ガラス繊維、シリカ球、アルミナ粉末等を用いてもよい。また、この発明は上述した実施の形態に限定されることなく、この発明の範囲内で種々変形可能である。例えば、上述した実施の形態に

おいては、一方の基板上に立設された突起状のスペーサ を備えた液晶表示装置の組立について説明したが、この 発明は、球状のスペーサを有する液晶表示装置の組立に も適用可能である。

[0059]

【発明の効果】以上詳述したように、この発明によれば、画質の向上した液晶表示装置を高い歩留まりにて組立可能な液晶表示装置の組立方法を提供することができる。

10 【図面の簡単な説明】

【図1】この発明に係る組立方法を適用する液晶表示装置の一例を示す断面図。

【図2】この発明に係る組立方法の実施に用いる組立装置の一例を概略的に示す側面図。

【図3】上記液晶表示装置のアレイ基板および対向基板 を示す分解斜視図。

【図4】この発明の実施の形態に係る組立方法を概略的 に示す図。

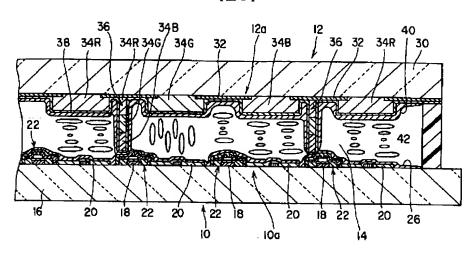
【図5】この発明の第2の実施の形態に係る組立方法に 20 おけるシール材の塗布状態を示す液晶表示装置の分解斜 複図。

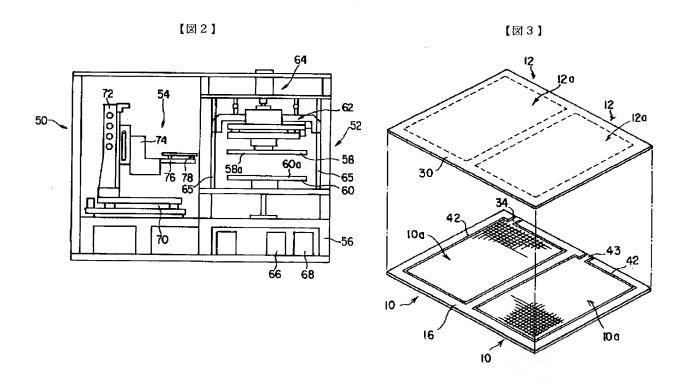
【図 6 】上記第 2 の実施の形態に係る組立方法を概略的 に示す図。

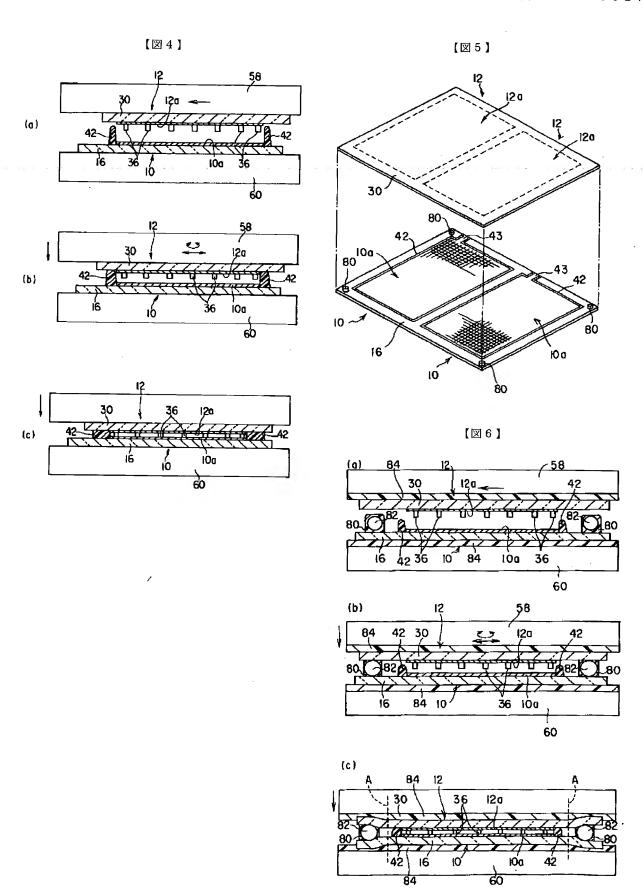
【符号の説明】

- 10…アレイ基板
- 12…対向基板
- 10a、12a…表示領域
- 14…液晶組成物
- 16、30…ガラス基板
- 30 20…画素電極
 - 26、40…配向膜
 - 36…スペーサ
 - 38…対向電極
 - 42…シール材
 - 80…第2のシール材
 - 8 2 …粒子

【図1】







フロントページの続き

(72)発明者 室内 克徳

兵庫県姫路市余部区上余部50番地 株式会

社東芝姫路工場内

(72)発明者 本田 端

兵庫県姫路市余部区上余部50番地 株式会

社東芝姫路工場内

(72)発明者 田中 孝臣

兵庫県姫路市余部区上余部50番地 株式会

社東芝姫路工場内

(72)発明者 倉内 昭一

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株

式会社東芝横浜事業所内